



ADVANTEST[®]

2023年度（2024年3月期） 第2四半期決算説明会

2023年10月31日
株式会社アドバンテスト

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ご注意

会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。



```
...mirror_ob.select = 0
operation == "MIRROR_X":
    @mirror_mod.use_x = True
    @mirror_mod.use_y = False
    @mirror_mod.use_z = False
    operation == "MIRROR_Y":
    @mirror_mod.use_x = False
    @mirror_mod.use_y = True
    @mirror_mod.use_z = False
    operation == "MIRROR_Z":
    @mirror_mod.use_x = False
    @mirror_mod.use_y = False
    @mirror_mod.use_z = True

selection at the end -add @
    @ob.select = 1
    @mirror_ob.select = 1
    @context.scene.objects.active
    @ob.name = "Selected" + str(modifier)
    @mirror_ob.select = 0
```

2023年度第2四半期決算報告

経営執行役員

CFO(Chief Financial Officer) & CSO(Chief Strategy Officer)

経営戦略本部長 三橋 靖夫

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ADVANTEST[®]

四半期業績推移

(億円)

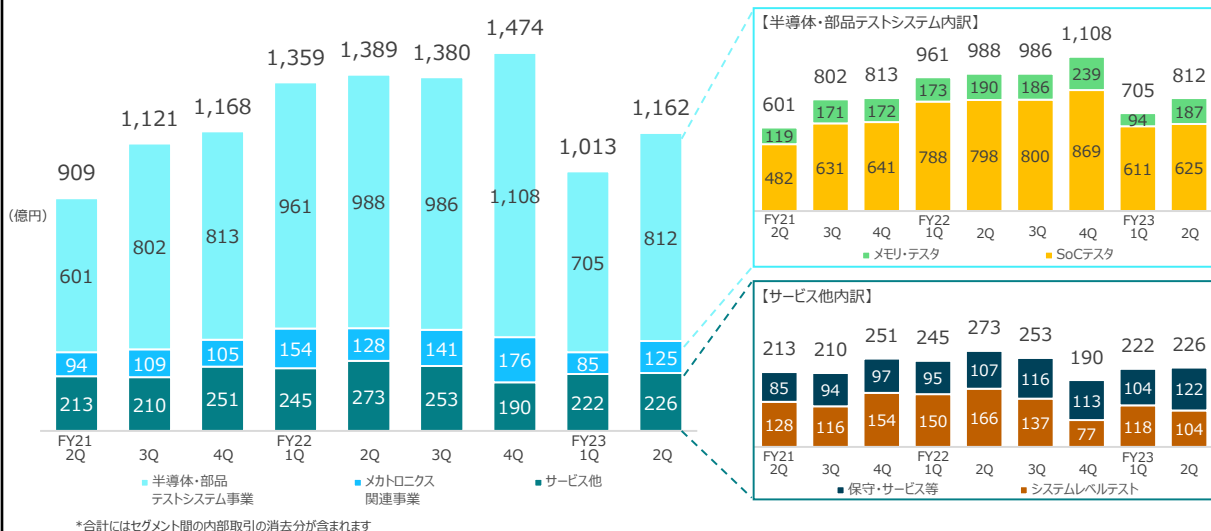
	FY22				FY23						
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q		前期比		前年同期比	
						予想	実績	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	1,359	1,389	1,380	1,474	1,013	1,127	1,162	+150	+14.8%	-226	-16.3%
売上総利益	789	799	816	787	510	-	580	+71	+13.9%	-218	-27.3%
売上総利益率	58.1%	57.5%	59.1%	53.4%	50.3%	-	49.9%	-0.4pts		-7.6pts	
営業利益	448	431	412	386	143	223	210	+67	+47.2%	-221	-51.3%
営業利益率	32.9%	31.1%	29.9%	26.2%	14.1%	19.8%	18.1%	+4.0pts		-13.0pts	
税引前四半期利益	484	468	377	384	130	222	203	+74	+57.1%	-265	-56.5%
四半期利益	365	347	286	306	92	168	167	+75	+81.9%	-179	-51.7%
四半期利益率	26.8%	25.0%	20.8%	20.8%	9.1%	14.9%	14.4%	+5.3pts		-10.6pts	
為替レート	1米ドル	124円	135円	144円	133円	135円	142円	7円 円安		7円 円安	
	1ユーロ	134円	139円	144円	142円	146円	156円	10円 円安		17円 円安	
1株当たり配当額*1	-	65円	-	70円	-	65円	65円				

*1:当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。FY22およびFY23 2Q末については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております

○ 2023年度第2四半期の業績概要

- 第2四半期実績は売上、利益ともに第1四半期を上回る結果となりました。
- 対米ドルにおける円安の進行も当社業績を押し上げましたが、スマートフォン関連を中心に顧客の投資抑制が継続しており、前期に引き続き厳しい事業環境となりました。
- 売上総利益率は、製品ミックス悪化から前期を下回る結果となりました。
- 営業利益率は円安の影響もあり、前期を上回りました。
- 中間配当については、本日10月31日開催の取締役会において7月時点の予想と同じ1株当たり65円が決議されました。この65円は、10月1日付けでの4分割前の1株当たりの配当金額となります。
- 詳細は以降のスライドで順次ご説明いたします。

四半期売上高 事業セグメント別



○ 2023年度第2四半期の売上高

○ 半導体・部品テストシステム事業

- ・ SoCテストは、前期比13億円増の625億円でした。
- ・ 車載・産業機器向けなど、主に成熟プロセス関連の半導体向け売上が伸長しました。一方で、低調なアプリケーション・プロセッサ（APU）向けでは、売上が減少しました。需要が堅調なハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）用半導体向けでも売上は減少しましたが、顧客サプライチェーンにおけるテスト設備の余剰は消化されつつある中で、新規テスト設備の納入は緩やかな状況が続いています。
- ・ メモリ・テストは、前期比94億円増の187億円でした。不揮発性メモリ向けは前期に引き続き低調だったものの、生成AI向けなど高性能DRAM向けの増収が顕著でした。

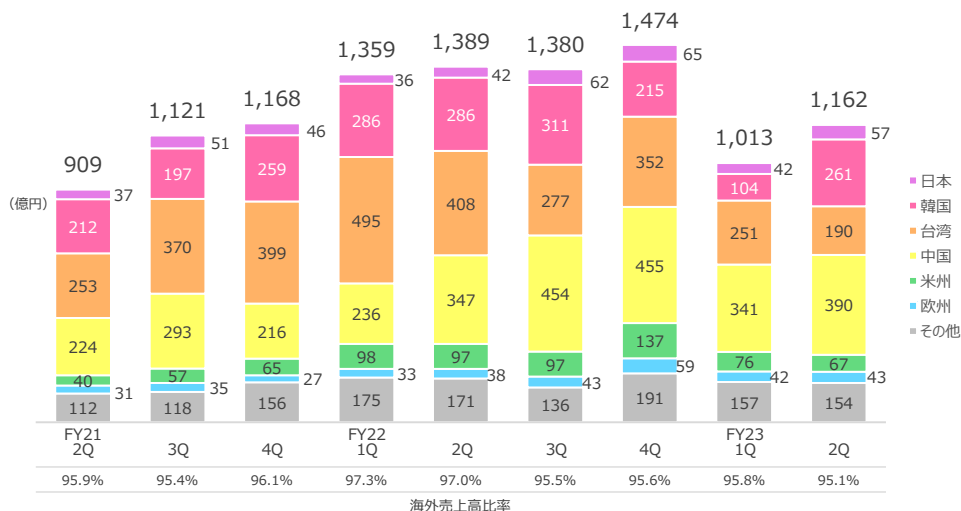
○ メカトロニクス関連事業

- ・ テスタの販売増に連動してデバイス・インタフェース、テスト・ハンドラの売上がそれぞれ前期比で増加しました。ナノテクノロジー製品も増収となりました。

○ サービス他

- ・ 前期並みの売上となりました。

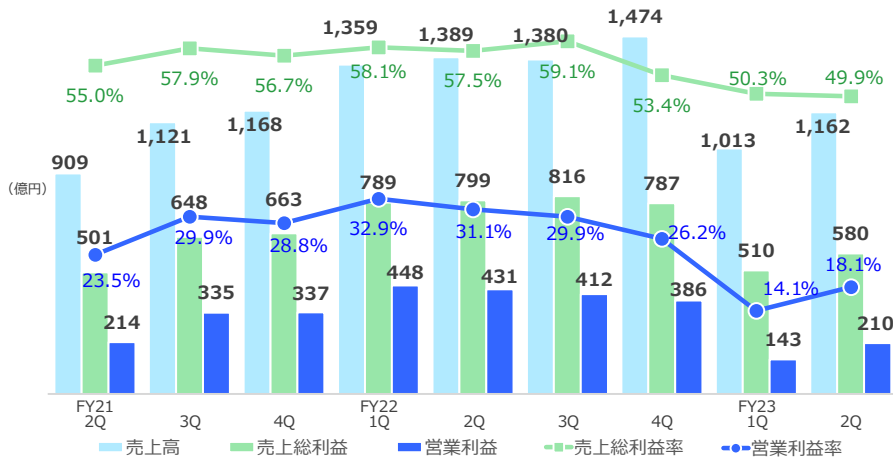
四半期売上高 地域(出荷先)別



○ 2023年度第2四半期の地域別売上高

- 韓国**
 メモリテストの売上が大きく伸びました。特にDRAM向けの伸びが目立ちました。加えてSoCテストの売上も好調でした。
- 中国**
 多品種の半導体に向けたテスト納入が進み、SoCテストおよびメモリテストでそれぞれ売上が増加しました。
- 台湾**
 スマートフォン関連のテスト設備の余剰が継続しており、ハイエンドSoC向け中心に売上が落ち込みました。スマートフォン向けからHPC向けにテスト構成変更も客先において進んでおり、今後の稼働率の改善と共に、台湾向けでの売上増加が見込まれます。

売上高/売上総利益/営業利益



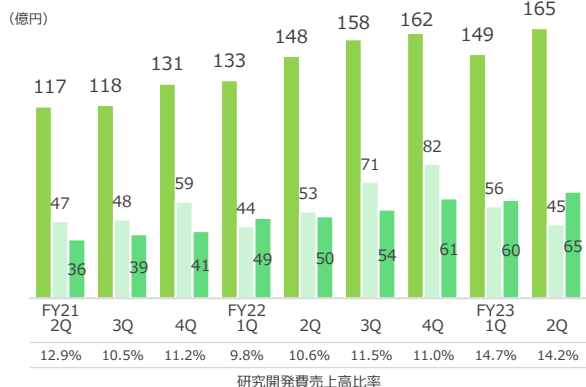
○ 2023年度第2四半期の売上高/売上総利益/営業利益

- 売上総利益率は7月の第1四半期決算発表の時点では第1四半期をボトムとし、第2四半期以降は改善を見込んでいました。
- しかしながら、ハイエンドSoC向けの売上が想定以上に復調しなかったことから、売上製品ミックスが悪化しました。加えて部材調達コストの上昇もあいまって、売上総利益率は前期を下回る結果となりました。
- 販売費および一般管理費等（その他収益・費用を合算）は前期並みの370億円でした。この中には取引先との係争に関する受取和解金等約32億円を含んでおりません。その結果、営業利益は210億円でした。

投資等/キャッシュ・フロー

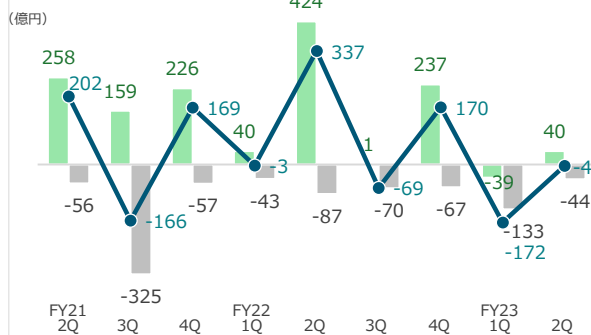
<投資等>

- 研究開発費
- 設備投資
- 減価償却費



<キャッシュ・フロー>

- 営業キャッシュ・フロー
- 投資キャッシュ・フロー
- フリー・キャッシュ・フロー



*フリー・キャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

○ 2023年度第2四半期の研究開発費等

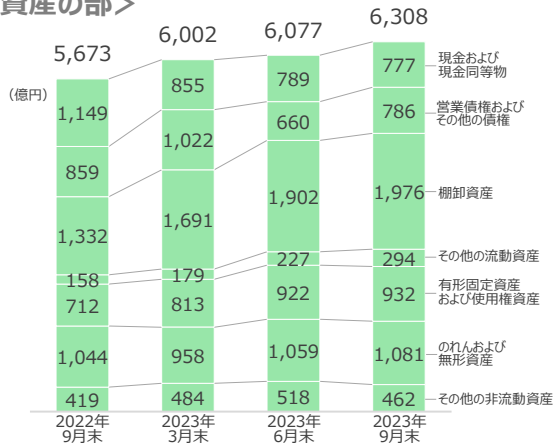
- ・ 研究開発費、設備投資、減価償却費は、概ね想定通りの進捗となりました。

○ 2023年度第2四半期のキャッシュ・フローの状況

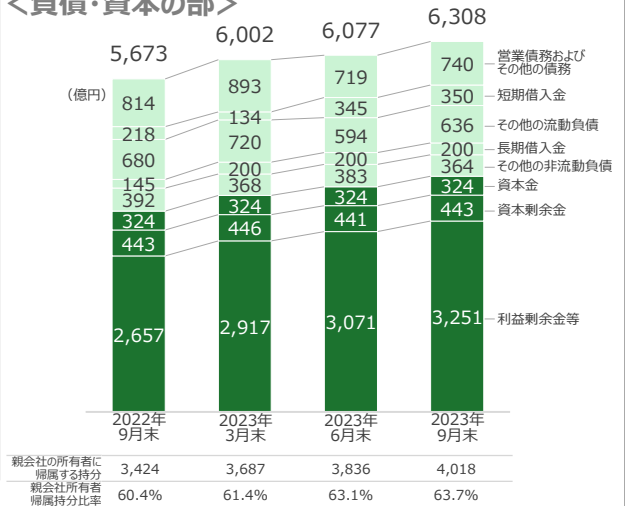
- ・ 第1四半期はShinPuu社買収にともない投資キャッシュ・フローの支出がありましたが、第2四半期のフリー・キャッシュ・フローは前期から168億円増加しました。

連結財政状態

<資産の部>



<負債・資本の部>



○ 2023年9月末時点のバランス・シート

- 営業債権およびその他の債権は、増収にともない、前期より126億円増加しました。
- 棚卸資産は、戦略的に調達した長納期部材の納入があるものの、前期同等のレベルとなっています。顧客の要求納期に応じた出荷体制構築を推進中ですが、今後ともこの棚卸資産をなるべく早期に資金化していくために、棚卸資産管理の強化によりいっそう努めてまいります。



2023年度事業見通し

代表取締役 兼 執行役員社長 Group CEO 吉田 芳明

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ADVANTEST[®]

事業環境と半導体テスト市場の動向 <23年10月時点の見方>

<事業環境>

- 世界経済は、中国の景気減速など回復が遅行。加えて、地政学的リスクの拡大や物価上昇、急激な為替変動リスクなど、依然として不確実性が高い状況が継続
- 半導体市場は、自動車や産業機器向けなどの一部の半導体需要は堅調。しかし、スマートフォンをはじめとした主要な民生機器向け半導体需要の減少に加え、データセンタ投資も減速していることから、関連する半導体メーカーでの設備投資の抑制が継続

<半導体テスト市場>

- SoCテスト市場は、車載・産業機器向けでは底堅い需要が持続。高性能半導体向けでは、顧客サプライチェーンにおけるテスト稼働率は改善されつつも、回復に想定より時間を要する見通し
- メモリ・テスト市場は、民生機器向けでは需要の低迷が継続しているものの、生成AI向けのHBMやDDR5などの高性能メモリ向けでは、顧客の生産計画の増加や品質保証強化の動きに連動したテスト需要が増加

	CY22実績	CY23推定
SoCテスト市場	約\$4.0B	約\$3.3B-3.4B (7月時点推定: 約\$3.2B-3.5B)
メモリ・テスト市場	約\$1.2B	約\$1.0B-1.1B (7月時点推定: 約\$0.9B-1.1B)

Source: Advantest

○ 事業環境と半導体テスト市場の見方

- 足元の事業環境は、中国の景気減速など世界経済の回復が遅れています。加えて、地政学的リスクの拡大や資源価格をはじめとした物価上昇、急激な為替変動リスクなど、依然として不確実性が高い状況が継続しています。
- 半導体市場は、自動車や産業機器向けなどの一部の需要は底堅く安定的に推移しています。しかしながら、スマートフォンをはじめとした主要な民生機器向け半導体需要の減少に加え、データセンタ投資も減速していることから、関連する半導体メーカーでの設備投資の抑制が継続されています。
- このような環境認識のもと、2023年のSoCテスト市場は、米ドルで33億ドルから34億ドルの間と見ています。市場規模予想のレンジ幅を7月見通しから調整します。3か月前の推定と比較し、車載・産業機器、ディスプレイ・ドライバーIC (DDIC) 向けでのテスト需要は堅実に納入が進捗したことから下限を引き上げた一方、主要民生機器向けの設備投資の抑制が続いていることから、上限値はアップサイドの可能性を引き下げました。コロナ禍で上昇した生産キャパの解消にはもう少し時間を要すると見ています。
- 2023年のメモリ・テスト市場は、米ドルで10億ドルから11億ドルの予想と下限を引き上げます。不揮発性メモリ向けでは需要回復の兆しが不透明な状況が続くものの、高性能メモリ向けでのテスト需要は、顧客の生産計画の増加や、品質保証強化の動きに連動したテスト需要が増加しています。
- HPC/AIなど高性能半導体向けでは、組み立て能力の増強の動きが本格化するなど、生産数量の増加が2024年以降見込まれます。また、半導体の付加価値を高めるための高性能化や、より高い信頼性を求める動きが、テスト量の増加を促す流れも強固です。この動きは、足元では顧客サプライチェーンのテスト設備の余剰を活用していますが、中期的な需要拡大の計画をもとに、当社顧客においては2024年から2025年にかけて投資計画を具体化する動きも見られます。

FY23業績予想

(億円)

	FY22	FY23						前年度比		(参考)新旧予想比較	
	実績	FY23		上期実績	下期予想	通期予想	増減額	増減率	7月時点 FY23予想	修正額	
		1Q実績	2Q実績								
売上高*1	5,602	1,013	1,162	2,175	2,525	4,700	-902	-16.1%	4,800	-100	
営業利益	1,677	143	210	353	447	800	-877	-52.3%	1,050	-250	
営業利益率	29.9%	14.1%	18.1%	16.2%	17.7%	17.0%	-12.9pts		21.9%	-4.9pts	
税引前利益	1,713	130	203	333	452	785	-928	-54.2%	1,035	-250	
当期利益	1,304	92	167	259	341	600	-704	-54.0%	780	-180	
当期利益率	23.3%	9.1%	14.4%	11.9%	13.5%	12.8%	-10.5pts		16.3%	-3.5pts	
研究開発費	601	149	165	314	326	640	+39	+6.5%	630	+10	
設備投資	250	56	45	101	109	210	-40	-16.0%	210	-	
減価償却費	214	60	65	125	135	260	+46	+21.5%	240	+20	
為替レート*2											
	1米ドル	134円	135円	142円	139円	145円	142円	8円 円安	135円	7円 円安	
	1ユーロ	140円	146円	156円	151円	155円	153円	13円 円安	149円	4円 円安	

*1: 合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

*2: 為替レート変動が今年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+9億円です。対ユーロは-3億円です

12 | ADVANTEST

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

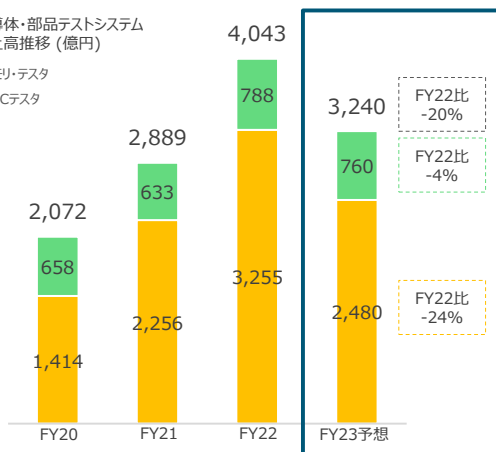
○ 2023年度の業績予想

- 上期実績と今後の見通しを踏まえ、2023年度の業績予想を下方修正します。
- 売上高は7月時点の予想より100億円引き下げ、4,700億円とします。
- スマートフォンをはじめとした主要な民生機器向け半導体の需要回復が遅れていることで、ハイエンドSoC向けテストの売上回復は、想定していた以上に時間を要する見通しです。
- 売上総利益率は、当初およそ55%程度を見込んでおりましたが、減収に加え、製品ミックスの悪化や部材調達コスト上昇からおよそ50%と見通しを引き下げます。営業利益率は不要不急なコスト削減を進めているものの、20%を下回る見通しに引き下げます。
- なお下期の予想の前提とした為替レートは、米ドルが145円、ユーロが155円といずれも円安方向に変更しています。
- 為替レート変動が今年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、通期で対米ドルでは1円安時+9億円、対ユーロでは-3億円です。米ドル取引での売上が減少する見込みのため、7月時点より米ドルでの感応度を2億円引き下げています。
- 米国および同盟国による半導体製造装置の対中輸出規制強化に関して、現時点では、当社の今期業績に対する直接的な影響は限定的と考えておりますが、状況が非常に流動的であり注視してまいります。

FY23見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム
売上高推移（億円）

■ メモリ・テスト
■ SoCテスト



半導体・部品テストシステム事業

<SoCテスト>（7月予想比 -200億円）

–成熟プロセス品向けは底堅いものの、スマートフォン市況の低迷を背景に先端プロセス品向けでの大幅な需要減を想定

アプリケーション別内訳	FY20	FY21	FY22	FY23(予)
コンピューティング・通信	55%	60%	65%	55%
車載・産業機器・民生・DDIC*	45%	40%	35%	45%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

<メモリ・テスト>（7月予想比 +60億円）

–不揮発性メモリ向けでは需要回復の兆しが見えない一方、DRAM向けではハイエンド品を中心に、顧客からの旺盛な投資を見込む

アプリケーション別内訳	FY20	FY21	FY22	FY23(予)
DRAM	60%	60%	60%	90%
不揮発性メモリ	40%	40%	40%	10%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

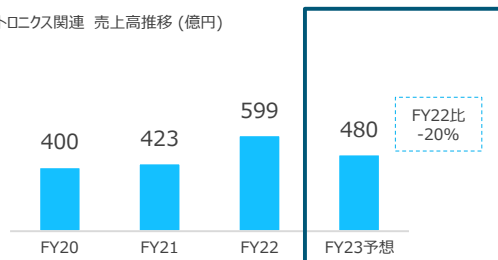
* DDIC:ディスプレイ・ドライバーIC

○ 半導体・部品テストシステム事業の今期見通し

- SoCテストの通期売上予想は、7月の見通しから200億円引き下げ、2,480億円です。
- 成熟プロセス品向けは、車載・産業機器関連に加え、DDIC向けなどでも顧客の投資は底堅く推移する見込みです。
- ただし、スマートフォンの需要低迷などを背景に、先端プロセス品向けの需要は想定以上に落ち込む見通しです。そのため今期のSoCテスト売上は前年度比で大幅な減収を見込みます。
- メモリ・テストの通期売上予想は7月の見通しから60億円引き上げ、760億円とします。
- HBM やDDR5といったハイエンドDRAM向けでは、生成AI関連も含め、中期的な需要拡大や高信頼性要求を背景に生産能力の増強に着手しており、顧客のテスト投資は今後さらに大きく増加する見込みです。

FY23見通し（事業別）

メカトロニクス関連 売上高推移（億円）

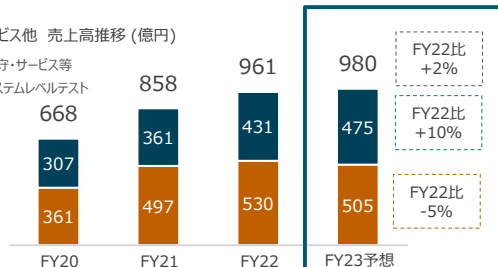


メカトロニクス関連事業（7月予想比 +60億円）

–メモリ・テストの売上予想引き上げに伴い、関連するデバイス・インタフェース製品やテスト・ハンドラの売上予想を引き上げたことから、7月予想比では増収見込み

サービス他 売上高推移（億円）

■ 保守・サービス等
■ システムレベルテスト



サービス他事業（7月予想比 -20億円）

–当社製品の設置台数の着実な伸びにより、保守サービスの需要は堅調

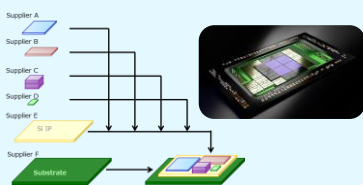
–システムレベルテスト事業は、半導体市況低迷を受けた顧客の投資動向の影響を受け、前年度比減収を見込む

○ メカトロニクス関連、サービス他事業の今期見通し

- メカトロニクス関連事業の通期売上予想は7月の見通しから60億円増額しています。
- メモリ・テストの通期売上予想引き上げに伴い、関連するデバイス・インタフェース製品やテスト・ハンドラの売上が増加する見込みです。
- サービス他事業については、通期売上予想を7月の見通しから20億円引き下げます。
- サービス保守事業は、当社製品の設置台数の着実な伸びを受けて、底堅い需要を見込んでいますが、システムレベルテスト事業においては、半導体市況低迷を受けた特定顧客の投資動向の影響を受け、前年度比減収を見込んでおります。

生成AIがもたらす当社の事業機会①

2.5D/3Dなど先端パッケージの増加 テストの重要性増加によりテスト時間増大



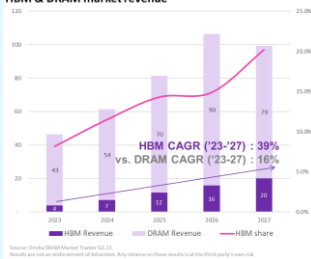
微細化・大規模化が半導体の複雑化を促進 新しい故障モデルへの対応などにより テスト時間の増加



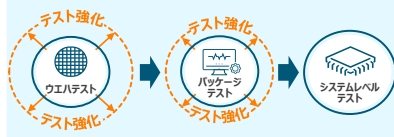
サプライチェーンの多様化 地政学的リスクヘッジにより 世界中で半導体の生産能力増強



HBM / DDR5など高性能メモリの増加 HBM & DRAM market revenue



高機能化、複雑性増加から品質保証を強化 テスト工程の増加



半導体開発に新規顧客の増加

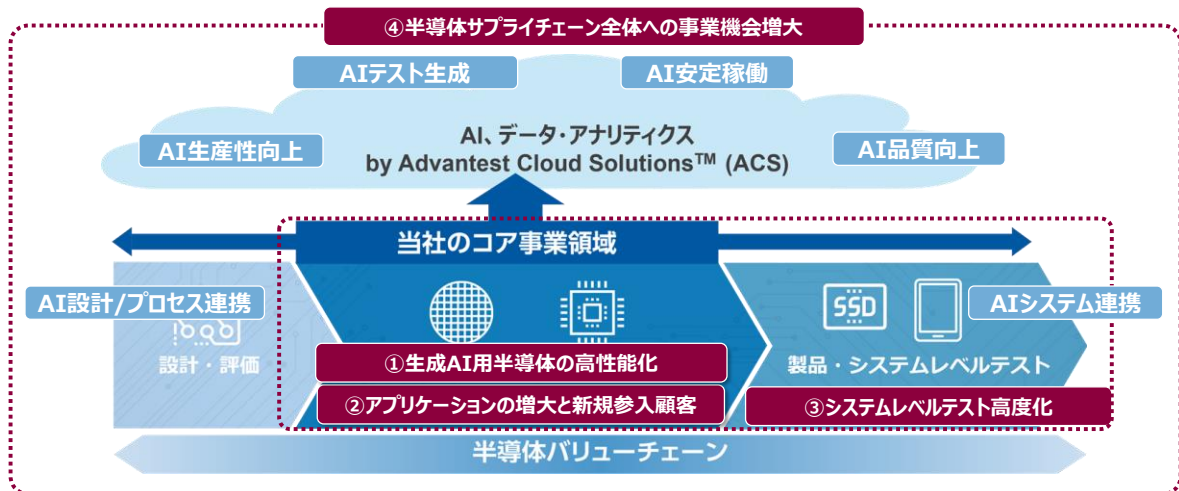
AI向けサーバーからエンドアプリケーションまで
多様なアプリケーションの開発競争



○ 生成AIがもたらす当社の事業機会①

- ここまで、今期の事業見通しについて需要回復が3か月前に比べ、なお緩慢なペースであり、立ち上がりが遅れていることをお話ししてきましたが、生成AIがもたらす当社の事業機会については、具体的な進展も実感してきた3か月でもありました。
- テスタの需要を増やす要因には、半導体の複雑化や品質保証強化など技術的な変化に応じたテストの強化と、半導体生産数量の増加という2つの軸があります。これをこの図であらわそうとしています。
- 半導体の技術進化に応じるテスト強化については、3nmプロセスへの移行などの微細化の進展により、新しい故障モデルへ対応することでのテスト時間増加や、ダイレベルで積層して実装する先端パッケージでは、品質保証を強化するためテストの重要性が増加するなど、先端技術の採用によりテスト需要が増加しています。
- 半導体生産数量の増加という観点では、半導体大手ファウンドリにおいて、暦年2024年より先端パッケージの組み立て能力が段階的に増強される見通しが示されています。また、HBMなどの高性能メモリを開発、量産する顧客でも、中期的な需要拡大や高信頼性要求を背景として、既に生産能力の増強に着手しています。今後のテスタ需要増加の計画について顧客と具体的な議論が日々増加している状況です。
- さらに、生成AIに関連してサーバーからエンドアプリケーションまで、多様な機能を有する半導体の設計に取り組む複数の新たなプレーヤーにも具体的なプロジェクトの進展があります。それらの複数のプロジェクトが進展することで、2024年を起点とする中期的なテスタ需要の拡大が期待できます。

生成AIがもたらす当社の事業機会②



○ 生成AIがもたらす当社の事業機会②

- この図は過去にもご説明していますが、グラウンドデザインの絵を展開したものです。
- AI関連の半導体では、先端パッケージが普及する中で、前工程でのウエーハテストが重要になります。加えて、組み立て後のパッケージテスト、そしてシステムレベルテストと様々なテスト工程での半導体の品質向上のための努力が重要となっています。
- さらに、顧客における半導体の歩留まり向上に対しては、設計から製造までの一連のプロセスにおいて、当社が長年蓄積してきた幅広いテストに関する知見を活かし品質向上を追求することが重要となっています。
- 今後は、顧客において、生成AI技術が半導体開発・製造におけるプロセスそのものを変えていく可能性が高いと考えています。様々なデータを活用し、開発、製造に活かしていく取り組みに当社はAdvantest Cloud Solutions™ (ACS) を通じて新たなソリューションを提供することで、顧客のTime to Market, Time to Volume, Time to Quality に貢献していけるものと思っています。

サマリー

・ 通期業績予想を下方修正

- スマートフォン関連の需要回復の遅れに伴い、7月時点の予想より売上高は100億円引き下げ
- HPC/AIなど高性能半導体向けのテスト需要は上向くも、テスト設備の余剰消化にはなお時間を要す

・ 生成AIがもたらす当社の事業機会は着実に進展、テスト需要は中期的に拡大

- 将来必要となる技術に対応する研究開発投資は継続（FY2022実績 601億円 → FY2023予想 640億円）

・ 収益性改善の施策も強化

- サプライチェーン管理の高度化により、需要変動への追従力を強化
- 販売価格の見直し、原価低減活動などを通じた売上総利益率の向上
- 事業プロセスの見直し、不要不急なコストの削減
- DXを積極的に活用し、全社オペレーションの効率向上に向けた活動を強化

○ サマリー

- ・ 7月時点で予想した通期業績売上高4,800億円を100億円引き下げ、4,700億円と予想を下方修正いたします。スマートフォン関連の需要回復の遅れに伴い、顧客の設備投資抑制が続いており、テスト設備の余剰消化には、7月の想定に比べ、なお時間を要するものと考えています。
- ・ 前述したように、生成AIがもたらす事業機会は着実に進展しており、テスト需要は中期的に拡大するという見方は変わりません。そのような中、当社は将来必要となる技術に対応するため、研究開発投資はしっかりと継続していきます。
- ・ しかしながら、今期の事業環境は想定よりも低調な期間が長引いています。サプライチェーン管理の高度化により、顧客の要求納期に応じた出荷体制構築を進めることで、需要変動への追従力を強化していきます。
- ・ また、部材調達コストの上昇を踏まえ、販売価格の見直しや、原価低減活動などを通じた、売上総利益率の向上策を実行していきます。足元では、不要不急なコストの削減や一部部門の人員削減は実施済ですが、さらに業務プロセスの見直しなどの経費削減を強化していきます。
- ・ さらに、DXを積極的に活用し、全社オペレーションの効率向上に向けた活動を強化するなど、中長期的な収益性改善の施策にも注力してまいります。

その他トピックス

- **統合報告書2023を発行**

※当社ウェブサイトリンク：<https://www.advantest.com/ja/about/annual.html>

- **サステナビリティ・データブック2023を発行**

※当社ウェブサイトリンク：<https://www.advantest.com/ja/sustainability/report/>

- **IR技術説明会(メモリテスト関連)を11月29日に開催予定**

○ その他トピックス

- 最後にご案内です。
- 10月20日に統合報告書2023、サステナビリティ・データブック2023を発行いたしました。
- 今年度も11月29日に当社事業への理解を深めていただく取り組みとして技術説明会を開催予定です。
- 私からの説明は以上となります。

ADVANTEST®

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION